

天德钰：深入前沿技术研究 成为移动智能终端显示驱动芯片领域领先者

——深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

深圳天德钰科技股份有限公司董事长、总经理
深圳天德钰科技股份有限公司财务总监、董事会秘书

郭英麟先生
邓玲玲女士

中信证券股份有限公司投资银行委员会董事总经理、综合行业组(深圳)行政负责人
中信证券股份有限公司投资银行管理委员会高级副总裁、保荐代表人
中信证券股份有限公司投资银行管理委员会副总裁、保荐代表人

童育坚先生
吴恢宇先生
禹明旺先生

深圳天德钰科技股份有限公司
董事长、总经理郭英麟先生致辞



尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：

大家好！
欢迎大家参加深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流活动。在此，我谨代表天德钰，向关心与支持天德钰的广大投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
天德钰成立于2010年，是一家专注于移动智能终端领域芯片研发、设计及销售的企业。公司立足中国市场，面向全球发展，为客户提供手机、智能穿戴装置、智能音箱、智能物联网等众多人机互动应用领

域芯片。公司产品丰富，涵盖智能移动终端显示屏驱动芯片、电子标签驱动芯片、摄像头音圈马达驱动芯片、快速充电协议芯片及解决方案等。公司深耕显示驱动领域数十年，产品销售覆盖中、美、日、韩等国家和地区，主要客户为国内外一流知名品牌企业。同时，公司技术能力突出，合计拥有专利107项，其中发明专利36项、实用新型专利10项、集成电路布局图专利69项。

公司本次股票发行募集的资金将重点用于“移动智能终端整合型芯片产业化升级项目”和“研发及实验中心建设项目”。展望未来，公司将积极把握下游行业发展机遇，通过加强技术研发、提高产品附加值等多种方式，提升公司产品及技术的市场竞争力，致力于围绕移动智能终端提供多种关键芯片，成为移动智能终端显示驱动芯片领域的领先者。
通过本次网上路演，我们希望广大投资者能够对天德钰有一个更全面的了解。今后，天德钰的发展将与广大投资者的利益紧密相连，期盼得到您更多的帮助与支持。我们也将借助资本市场这一更高更广阔的平台，再创佳绩，回报广大投资者的信任、回馈社会！
谢谢大家！祝明天会更好！

中信证券股份有限公司
投资银行委员会董事总经理、综合行业组(深圳)
行政负责人童育坚先生致辞



尊敬的各位嘉宾、投资者朋友们：

大家下午好！
非常荣幸能够参加今天的网上路演活动。我谨代表中信证券股份有限公司，对所有参加深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演推介活动的各位嘉宾和投资者，表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
天德钰是集成电路设计企业，专注于智能移动端、智能物联领域的关键芯片设

计、研发。公司登陆资本市场后，将成为第一家以显示驱动芯片为主业的A股公司。未来，公司将继续深入前沿技术研究，全面提升产品服务竞争力，全力推动显示等领域关键芯片的发展，向更多全球知名的品牌客户提供关键芯片的完整解决方案，努力成为智能物联领域关键芯片的全球领航者。

作为天德钰首次公开发行的保荐机构和主承销商，我们见证了公司在发展过程中取得的骄人业绩，也亲身感受到了公司管理层高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光。未来，我们将严格按照法规要求履行保荐职责和持续督导义务，陪伴天德钰发展壮大。我们真诚地希望通过本次网上路演推介活动，能让广大投资者更加深入地了解天德钰，更准确地把握其投资价值和投资机会！我们对天德钰的发展前景充满信心，希望通过我们和公司的共同努力，能与广大投资者共同分享企业发展的硕果！

最后，预祝天德钰首次公开发行股票网上路演圆满成功！谢谢大家！

深圳天德钰科技股份有限公司
财务总监、董事会秘书邓玲玲女士致辞



尊敬的各位投资者、各位网友：

大家好！
深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演已近尾声，十分感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供这么好的沟通平台和优质的服务。借此机会，还要感谢保荐机构中信证券及其他所有为天德钰发行上市辛勤付出

的中介机构！
今天，有机会与这么多关心、关注天德钰的投资者朋友共同探讨公司的战略规划、经营管理和未来发展，我们感到十分高兴。大家提出了很多非常有价值的意见和建议，在今后的经营管理中，我们一定会认真考虑这些意见和建议，并把朋友们的真知灼见融入天德钰的经营管理工作之中，创造出更好的业绩来感谢大家的关心与厚爱。

由于时间关系，我们无法一一回答投资者提出的问题，但天德钰与投资者之间的沟通交流是持续和畅通的。欢迎大家通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们随时保持联系，也欢迎大家来天德钰进行实地考察。
我们真诚希望能够通过今天的网上路演，通过彼此间坦诚的交流，来开启天德钰与各位投资者朋友紧密沟通的大门。期待着各位成为公司股东，与我们携手共创天德钰的美好未来！
最后，再次感谢各位投资者对天德钰的信任与支持！谢谢大家！



经营篇

问：公司的主要产品有哪些？

郭英麟：公司目前拥有智能移动终端显示驱动芯片[DDIC，含触控与显示驱动集成芯片（TD-DI）]、摄像头音圈马达驱动芯片（VCM Driver IC）、快充协议芯片（QC/PD IC）和电子标签驱动芯片（ESL Driver IC）四类主要产品，广泛应用于手机、平板/智能音箱、智能穿戴、快充/移动电源、智能零售、智慧办公、智慧医疗等领域。

问：请介绍公司的主营业务经营情况。

郭英麟：公司为一家专注于移动智能终端领域的整合型单芯片的研发、设计、销售企业。公司采用Fabless经营模式，专注于产品的研发、设计和销售环节，产品生产及封装测试分别由晶圆生产企业及封装测试企业完成。公司凭借可靠的产品质量、扎实的技术水平、高效的客户服务能力、强大的供应链垂直整合能力及较高的性价比，形成了较强的市场竞争力。在DDIC及TDDI领域，公司已成为国内有一定影响力的供应商，报告期内（2019年、2020年、2021年，下同）累计出货4.59亿颗；在VCM Driver IC领域，报告期内累计出货6.97亿颗；在QC/PD IC领域，报告期内累计出货3.20亿颗；在ESL Driver IC领域，报告期内累计出货0.53亿颗。

问：公司有几家子公司和分公司？

禹明旺：截至招股说明书签署日，公司拥有3家全资子公司、3家分公司、2家参股公司。此外，公司报告期内注销1家分公司和1家参股公司。

问：公司有哪些知名客户？

郭英麟：公司注重与下游模组厂、面板厂、系统厂及终端客户的合作及服务，已与BOE、群创光电、华星光电、合力泰、国显科技、星源电子、华勤通讯、闻泰科技、龙旗通讯等知名下游企业建立了稳定的合作关系，产品广泛应用于华为、小米、三星、vivo、传音、中兴等手机品牌；亚马逊、谷歌、百度等平板/智能音箱客户；三六零、小天才等智能穿戴客户。

问：公司的营业收入是多少？

邓玲玲：报告期内，公司分别实现营业收入46423.04万元、56094.68万元、111571.24万元。公司主营业务收入主要来自显示驱动芯片（含触控与显示集成芯片），报告期内，该等芯片产生的收入分别为36406.96万元、44603.25万元、83534.93万元，占公司营业收入的比例分别为78.67%、80.21%、74.87%。

问：公司主营业务毛利率是多少？

邓玲玲：报告期内，公司主营业务毛利率持续提高，分别为19.86%、26.15%和51.17%。2019年公司毛利率增加主要系公司加大了毛利率更高的ESL DRIVER IC、VCM DRIVER IC等产品的投入；2020年公司毛利率大幅提升主要系受下游市场需求扩张和晶圆产能紧缺的影响，2020年第四季度芯片行业价格上涨，公司产品销售价格也同步上调；因下游市场需求扩张、产品价格上涨，2021年度毛利率增幅较大。

问：公司的净利润是多少？

邓玲玲：报告期内，公司分别实现净利润1727.77万元、6074.57万元、32931.85万元。

问：公司的研发投入是多少？

邓玲玲：公司注重研发投入，报告期内，公司研发费用分别为5667.17万元、5652.60万元、13116.60万元，研发投入持续稳定增长。

发展篇

问：请介绍公司未来的发展战略。

郭英麟：1）公司战略目标。未来，公司将积极把握下游行业发展机遇，通过加强技术研发、提高产品附加值等多种方式，提升公司产品及技术的市场竞争力，并通过进一步加深与重点客户的业务合作，加强国内和国际市场拓展力度，致力于围绕移动智能终端提供多种关键芯片，成为移动智能终端显示驱动芯片领域的领先者。

2）公司的战略规划。未来公司将立足于移动智能终端的巨大发展空间及市场机遇，实施差异化竞争战略，重点布局手机、平板/智能音箱、可穿戴设备、移动充电、智能物联等领域的高端产品；加强创新型技术研发，提高产品附加值，提升公司产品市场竞争力；进一步加深与重点客户的业务合作，加强国内和国际市场拓展力度，提高市场占有率。

问：公司的竞争优势有哪些？

郭英麟：通过长期的研发投入与市场开拓，公

司在相关业务领域已具备较强的竞争优势：1）优异的研发能力和深厚的技术积累；2）多元化的产品布局；3）稳定优质的客户资源；4）杰出的供应链管理；5）优秀的研发及管理团队。

问：公司在研发技术方面有哪些优势？

郭英麟：公司自成立以来，即专注于移动智能终端领域的整合型单芯片的研发、设计及销售，具有长期的研发经验和雄厚的技术积累。依靠强大的研发能力和技术积累，公司不断拓展公司产品线及应用领域。截至招股书签署日，公司及子公司合计拥有专利38项，其中发明专利36项、实用新型专利2项，在美国授权的有5项。此外，公司及子公司共拥有集成电路布图设计69项。凭借优异的研发能力和深厚的技术积累，公司产品具有质量稳定、性能优异、成本较低等多种优势，对公司扩大产品影响力、提升市场份额具有重要作用。

问：请介绍公司的技术创新机制。

郭英麟：公司的技术创新机制有：1）“以客户为中心，以市场为导向”的技术创新机制。公司秉持“以客户为中心，以市场为导向”的技术创新机制，紧密跟踪市场技术及产品变化趋势，通过市场调研、客户服务等方式实时了解客户的产品和技术需求，为公司新产品的开发及现有产品的技术升级提供思路及方向，以提高研发效率及成功率，及时满足市场及客户的需求。2）有效的员工激励机制。公司建立了完善科学的绩效考核与激励机制，以鼓励研发设计人员积极进行自主创新。公司将创新成果作为研发人员绩效考核的重要指标，从奖金和股权上对技术创新给予奖励，调动了研发人员的积极性并避免了核心技术人员的流失。同时，公司鼓励员工进行各种职务创新发明和专利申请，对专利申请者或有重大创新贡献者给予精神奖励和物质奖励。3）完善的人才培养机制。公司高度重视人才培养，针对不同岗位建立了完善、成熟的培训体系，鼓励团队间的技术交流和良性竞争，并定期组织员工进行外部学习交流，保持研发团队对市场趋势变动和行业技术发展的敏感度。

行业篇

问：请介绍公司所属行业近三年的发展情况和未来发展趋势。

郭英麟：1）下游应用需求多样化推动行业技术变革。集成电路行业的发展遵循摩尔定律，在芯片设计方面，随着5G、物联网技术的普及，下游应用端需求趋向多样化，产品性能日益提升，将推动上游设计行业研发新技术、新产品，亦推动中游制造行业不断推出新制程、新工艺；在晶圆制造环节，制程工艺日益精进；在封装测试方面，各种类型封装技术相继推出，以满足不同细分领域芯片的封装需求。随着未来新型需求的出现，集成电路行业技术水平将继续加速变革。

2）集成电路行业发展加速。受益于经济增长及产业政策的大力支持，我国半导体及集成电路行业处于持续高速增长阶段。据IC Insights数据显示，我国芯片市场规模从2010年的570亿美元提升至2020年的1430亿美元。根据IC Insights预测，至2023年，中国集成电路市场规模将增至2230亿美元，市场规模持续扩大。同时，2018年以来，海外不确定因素为国内集成电路企业带来了发展机遇，亦将加快集成电路的国产化发展进程。

3）集成电路设计行业占比持续提升。集成电路设计行业是技术密集型行业，对研发实力要求较高。经过多年发展，国内逐步形成以设计业为龙头、封装测试为主体、芯片制造为重点的产业格局，芯片设计逐渐成为集成电路产业发展的源头和驱动力。据中国半导体协会、中国产业信息网统计，国内集成电路行业设计环节销售额占比从2012年的28.80%增长至2019年的40.50%。随着集成电路行业专业化分工，集成电路设计行业占比将持续提升。

问：请介绍显示面板驱动芯片的市场状况。

郭英麟：据Frost&Sullivan统计，全球显示驱动芯片出货量由2012年的88.4亿颗上升至2019年的156.0亿颗，年均复合增长率达到8.4%。未来，显示技术的升级与下游应用的拓展将推动显示驱动芯片市场进一步增长，预计到2024年全球显示驱动芯片出货量将达到218.3亿颗，复合增长率达7.0%。

问：行业目前面临的机遇有哪些？

郭英麟：行业目前面临的机遇有：1）有利的政策环境带来行业发展黄金期；2）我国成为全

球半导体产业聚集地；3）移动智能终端需求稳定增长为行业发展提供坚实基础。

问：智能移动终端显示驱动芯片行业的主要企业有哪些？

郭英麟：智能移动终端显示驱动芯片行业的主要企业有联咏科技股份有限公司、奕力科技股份有限公司、敦泰电子股份有限公司、矽创电子股份有限公司、格科微有限公司。

问：公司的市场地位如何？

郭英麟：报告期内，公司与知名下游终端客户进行了较好的长期合作，具有较强的市场竞争力。智能移动终端显示驱动芯片方面，公司产品已广泛应用于华为、小米、传音、中兴等手机及亚马逊、谷歌、百度等平板/智能音箱。在智能手机领域，据CINNO Research统计，2021年上半年国内显示驱动芯片领域天德钰出货量占行业总出货量的比例约12%，排名行业第四；摄像头音圈马达驱动芯片方面，公司产品已应用于华为、三星、vivo等手机品牌客户；电子标签驱动芯片方面，公司产品应用于智能商超、智慧办公及智慧医疗领域，发展了较为稳定的国际客户资源；快充协议芯片方面，公司产品已广泛应用于移动电源、排插、旅充等众多领域，均具有较强的市场竞争力。

发行篇

问：请介绍公司的控股股东情况。

童育坚：截至招股说明书签署日，恒丰有限直接持有公司61.1551%的股份，系公司控股股东。报告期内，天钰科技通过Trade Logic Limited持有恒丰有限100%股权，为公司的间接控股股东。该控股情况最近两年未发生变更。

问：请介绍公司的实际控制人情况。

禹明旺：天钰科技作为公司的间接控股股东，通过Trade Logic Limited、恒丰有限间接受持有公司61.1551%股份。报告期内，根据天钰科技的《公司章程》以及中国台湾地区的相关规定，鸿海精密与天钰科技之间无控制关系，也没有其他股东能够控制天钰科技，故报告期内天钰科技不存在实际控制人，因此公司亦不存在控制人，且该等状态于最近两年内未发生变化。

问：请介绍持有公司5%以上股份的其他股东情况。

童育坚：截至招股说明书签署日，除控股股东外，公司持股比例超过5%的股东及其他主要股东分别为：Corich LP、宁波群志光电有限公司。

问：公司有外资入股吗？

童育坚：截至招股说明书签署日，公司外资股东为恒丰有限、Corich LP、Richred LP，分别持有公司61.1551%、8.5536%及2.0250%的股份。

问：公司所属行业是否符合科创板定位？

吴恢宇：公司为集成电路设计企业，根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C-65软件和信息技术服务业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为第65大类“软件和信息技术服务业”中的“I-6520集成电路设计”行业；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“新一代信息技术产业”之“电子核心产业”之“集成电路制造”行业，是国家重点发展的战略性新兴产业之一。因此，公司所在行业属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第四条第一款“新一代信息技术领域，主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、软件、互联网、物联网和智能硬件等”提及的产业领域。公司所属行业符合科创板定位。

问：公司选择的具体上市标准是什么？

吴恢宇：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件，公司符合上市条件中的“2.1.2（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”

问：公司本次拟发行多少股新股？

吴恢宇：公司本次拟发行新股4055.5600万股，公开发行的股份占发行后总股本的10%。问：公司本次募集资金投资项目是什么？

吴恢宇：公司本次募集资金扣除发行费用后将投资于移动智能终端整合型芯片产业化升级项目和研发及实验中心建设项目。

文字整理 姚桐

主办 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com)